

1-1470109-0 ✓ AKTIV

AMPMODU | AMPMODU 2 mm

Interne TE-Nummer 1-1470109-0

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 10 Position, 2 mm [.079 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin, Through Hole - Solder, Signal, AMPMODU 2 mm

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**

Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**

Steckverbindersystem: **Draht-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: 10

Raster: 2 mm [.079 in]

Eigenschaften

Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Vollständig ummantelt
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration	Parallel
Ladungszustand des Steckverbinderkontakts	Voll bestückt
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	10
Zeilenanzahl	2

Elektrische Kennwerte

Spannungsfestigkeit (max.)	750 VAC
Isolierwiderstand	5000 MΩ
Arbeitsspannung	100 VDC

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Naturbelassen
----------------------	---------------

Kontaktmerkmale

Länge des Steckbereichs des Kontakts	3 mm[.1 in][.138 in]
Abmessungen des Steck-Quadratpfostens	.5 mm[.02 in]
	100 µin
Kontaktaufbau	Verbindungsuffe
Kontaktform	Quadratisch
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Messing
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Zinn
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	2.54 µm[100 µin]
Kontakttyp	Stift
Kontakt-nennstrom (max.)	3 A

Klemmenmerkmale

Quadratischer Endverschluss, Anschlussstift- und Restabmessungen	.5 mm[.02 in]
Anschlussstift- und Restlänge	3 mm[.118 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

Typ der Gegensteckführung	Kodiert
Gegensteckführung	Mit
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Ohne
Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Raster	2 mm[.079 in]
Gehäusematerial	Hochtemperatur-Thermoplast

Abmessungen

Steckverbinderhöhe	6.5 mm
Leiterplattendicke (empfohlen)	1.57 mm[.062 in]
Reihenabstand	2 mm[.079 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]
---------------------------	---------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

Industriestandards

Zugelassene Standards	CSA LR7189, UL E28476
-----------------------	-----------------------

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	450
------------------	-----

Verpackungs-Typ	Karton, Tasche
-----------------	----------------

Weitere

Ausgelassene Positionen	0
-------------------------	---

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
-------------------------------	---------

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
------------------------------	---------

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
--	---

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2023 (235) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2023 (235) Enthält keine SVHC
--	---

Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
---------------	--

Lötfähigkeit	Nicht geeignet für bleifreie Verfahren
--------------	--

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | AMPMODU 2 mm



Kunden kauften auch diese Produkte

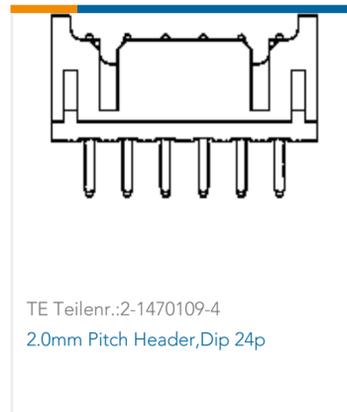




TE Teilnr.:1470106-1
2.0mm Pitch Crimp Contact



TE Teilnr.:1-2176339-5
CRGCQ 0603 150R 1%



TE Teilnr.:2-1470109-4
2.0mm Pitch Header,Dip 24p



TE Teilnr.:9-2176360-5
RQ 0402 4K12 0.1% 10PPM 1K RL

Dokumente

Produktzeichnungen

2.0mm Pitch Header,Dip 10p

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1-1470109-0_E.2d_dxf.zip

Englisch

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1-1470109-0_E.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1-1470109-0_E.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION3AND4

Englisch

HPI Connectors QRG

Englisch

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Englisch

Produktspezifikation

Englisch